



## 2017中国智能硬件峰会

尊敬的\_\_\_\_\_先生/女士，您好！

2017中国智能硬件峰会将于2017年10月在深圳召开。

### 会议内容

智能硬件是以平台性底层软硬件为基础，以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征，以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务。

中国智能硬件市场规模在2016年达到3315亿元人民币，预计2017年将达到3999亿，同比增长20.63%，智能硬件市场总体保持稳定的增长态势，预计到2019年，中国智能硬件市场规模将达到5411.9亿元。

但是对于智能硬件的初创企业来说，订单量往往成为自己的硬伤。对于工厂管理者而言，将公司资源向最大订单的客户倾斜，是必然的事情。因为频繁切换产品生产线，意味着工时的浪费和成本的增加，所以有些工厂面对找上门来的生意，往往张口就问：量有多少？面对前景未知的型号产品，很少有工厂愿意全力配合，这需要多年的合作和相互信任，非一朝一夕能做到。而智能硬件产品越来越复杂，需要的材料类型也越来越多，这时候就需要多方资源平台力量来协助支持。

为此，由寻材问料®与佳简几何®、电子发烧友®、深圳大学共同发起“**2017中国智能硬件峰会**”，旨在汇聚智能硬件产业链各方，搭建资源整合与产学研用平台，共同研判智能硬件创新趋势和方向，为产业链各环节提供资源整合平台，引领中国智能硬件创新发展潮流。

**会议主题：“新材料 新工艺 新设计”**

**会议时间：2017年10月29-31日**

**会议地点：深圳大学**

**主办单位：**寻材问料®、电子发烧友®、佳简几何®、深圳大学

**协办单位：**新材料在线®、硬蛋科技、华米、洛可可、浪尖设计、深圳创新设计研究院、一起上传媒、RFsister射频技术服务平台、普象工业设计、江南大学、清华大学研究院、Rokid、英伟达。

**媒体支持：**新材料在线®、寻材问料®、佳简几何®、易科学®

**会议亮点：**

**500+ 智能硬件产业企业**，包含上中下游企业

**20+ 国内外知名智能硬件产业代表人物**

**10+智能硬件产业主题演讲**

**为什么参加？**

把握趋势——行业动向、市场风云、发展趋势全掌握

交流经验——新设计、新材料、新工艺、新模式齐分享

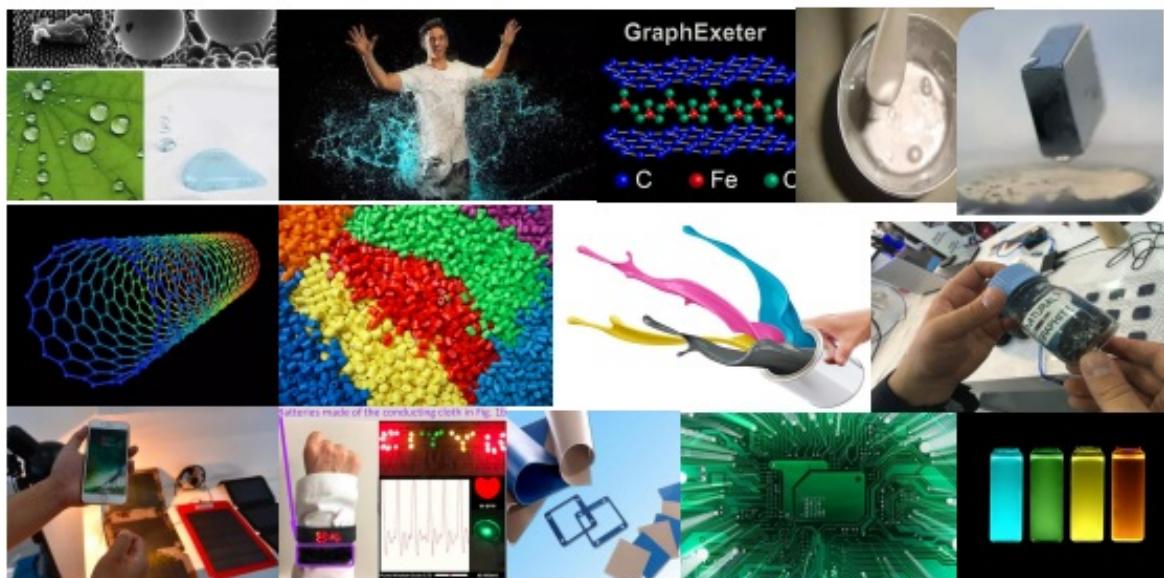
探讨方案——智造方案、产业链整合、投资合作当面聊

本次会议有以下几大亮点：

**亮点一：行业精英主题分享“成长与突破”**

本次年会主办方特邀优秀智能硬件厂家代表、内地智能硬件销售龙头企业 + 应用商家代表及行业大咖现场进行关于智能硬件行业2017年的设计潮流主题演讲。为什么这样设计产品？怎样优化产品？如何获得好的ID？如何选材用材？

**亮点二：百款智能硬件相关新材料展示**



本次会议主办方依托寻材问料/创新材料馆收集的100多款功能型智能硬件相关黑科技材料将在本次会议上展出，为现场观当众揭晓2017年智能硬件行业里到底有哪些最前沿，最好玩的黑科技材料可以或者即将应用到智能硬件上。

**亮点三：无人机拍摄大合影**



会议上，将由无人机飞手操控无人机为我们进行大合照

#### 亮点四：推广

百家媒体（平台）、全方位多角度持续推广

#### 亮点五：地理

立足深圳，辐射全国，来自全国的参会者带来行业内最新的供需信息；



### 会议日程

#### 活动安排：

阶段	时间	活动内容
10月29日 第一阶段 主题论坛	9:00-9:20	开幕式 战略合作协议签订及创新部落揭牌仪式
	9:20-12:20	智能设计
	14:00-17:20	智能硬件制造
10月30日	9:20-12:20	佳简几何设计公开课
		智能硬件天线设计常见误区及规避法则

第二阶段 深大公开课		普象工业设计公开课
		深圳大学创客学院公开课
		硬蛋创新公开课
	14:00-17:20	寻材问料/创新材料馆 参观及材料创新公开课
10月31日 第三阶段	9:20-12:20	深圳大学创业圈参观座谈

### 部分议题：

方向	序号	议题	演讲单位
新设计	1	智能硬件设计中的材料视角	佳简几何
	2	华米手环设计分享	华米
	3	AI音箱方案设计	拟邀 Rokid
	4	新型无线充电解决方案	电子发烧友
新材料	5	超疏水自洁材料应用	拟邀 中科院北京化学所 徐坚
	6	光子晶体在智能硬件中的应用	拟邀 中科纳福
	7	高性能投影全息膜	拟邀 光科全息
	8	p4u慢回弹吸能防护材料（微发泡聚氨酯）	拟邀 西安工业大学
	9	人类延寿技术，人体血管疏通用纳米智能材料	拟邀 福纳新材
	10	自修复水凝胶	拟邀 中科院先进院 陈涛
	11	纳米摩擦发电	拟邀 中科院 王中林
	12	line-x聚脲超强防护涂料	青岛沙木
	13	电控可变形液体金属机器人	拟邀 中科院理化所 刘静/云南中宣
	14	替代空调，TPX辐射冷却特种膜材料	拟邀 斯坦福大学 杨荣贵教授
	15	电子产品整体防水技术	Solvay

新工艺	16	小批量定制与供应链服务	寻材问料CEO 聂雷
-----	----	-------------	------------

## 会议嘉宾

同时，本次峰会将有重磅嘉宾空降现场，进行精彩分享与交流。既有来自知名科技公司大咖，也有来自多个领域的领军人物，将为现场观众带来一场前所未有的“黑科技”盛宴。

## 会议门票

会议费用：

费用(元/人)		
一人	两人	三人及以上
499	399	299

- 参会费用含会议门票、会议资料、午餐、茶歇等，不包括住宿；

